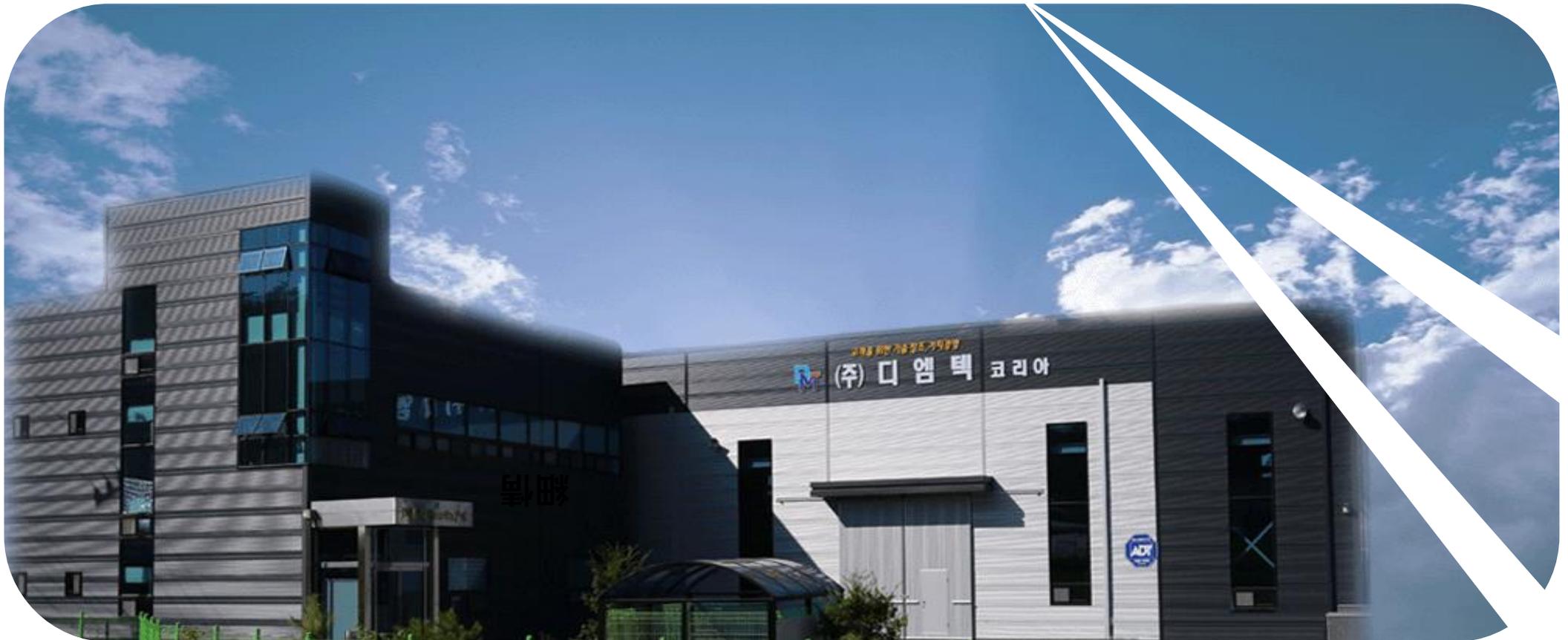


고객을 위한 기술창조, 가치 경영

(주)디엠텍 코리아 회사 소개서



 DMTEK korea Co.,Ltd

경기도 화성시 마도면 석교남길 63
TEL:031)355-9247 FAX:031)355-9257
E-mail:dmtekkorea@dmtekkorea.co.kr
홈페이지 : www.dmtekkorea.com

 DMTEk korea Co.,Ltd.

Contents

1. Company Introduction

2. CEO Message

3. Company Overview

4. History

5. Field of business

6. Organization

7. Certification

8. Product descriptions

9. Major Clients

10. Rough map

1

회사 소개



Welcome DMTEK

대한민국 장비분야의 기준이 되겠습니다.

당사는 Connector Auto Plating 자동 장비, 반도체 LEAD FRAME, PCB, EMI원단 도금장비 및 기타 도금관련 장비제작·설계 전문기업 입니다.

당사의 임직원은 Connector Auto Plating, EMI원단 도금장비 및 반도체 LEAD FRAME 제작경험, 도금 양산 장비의 제작 및 SET-UP경험을 바탕으로 하여 성능 좋고 저렴한 장비를 고객에게 제공해 드리고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

당사는 도금관련 장비분야의 핵심적 기술과 역량을 지속적으로 발전시켜 경쟁력을 갖춘 기업이 되고자 끊임없이 연구하고 노력 하여 고객의 성원의 보답하는 기업이 되고자 최선을 다하겠습니다.

CEO Message

2003년 시작된 DMTEK KOREA의 열정과 에너지는 매년 20%를 넘는 성장률을 보이고 있으며, 지난 2013년에는 첨단직 도금 장비 제조 기업으로 우뚝 서면서 해외 진출로의 새로운 사업영역을 확장해 오고 있습니다.

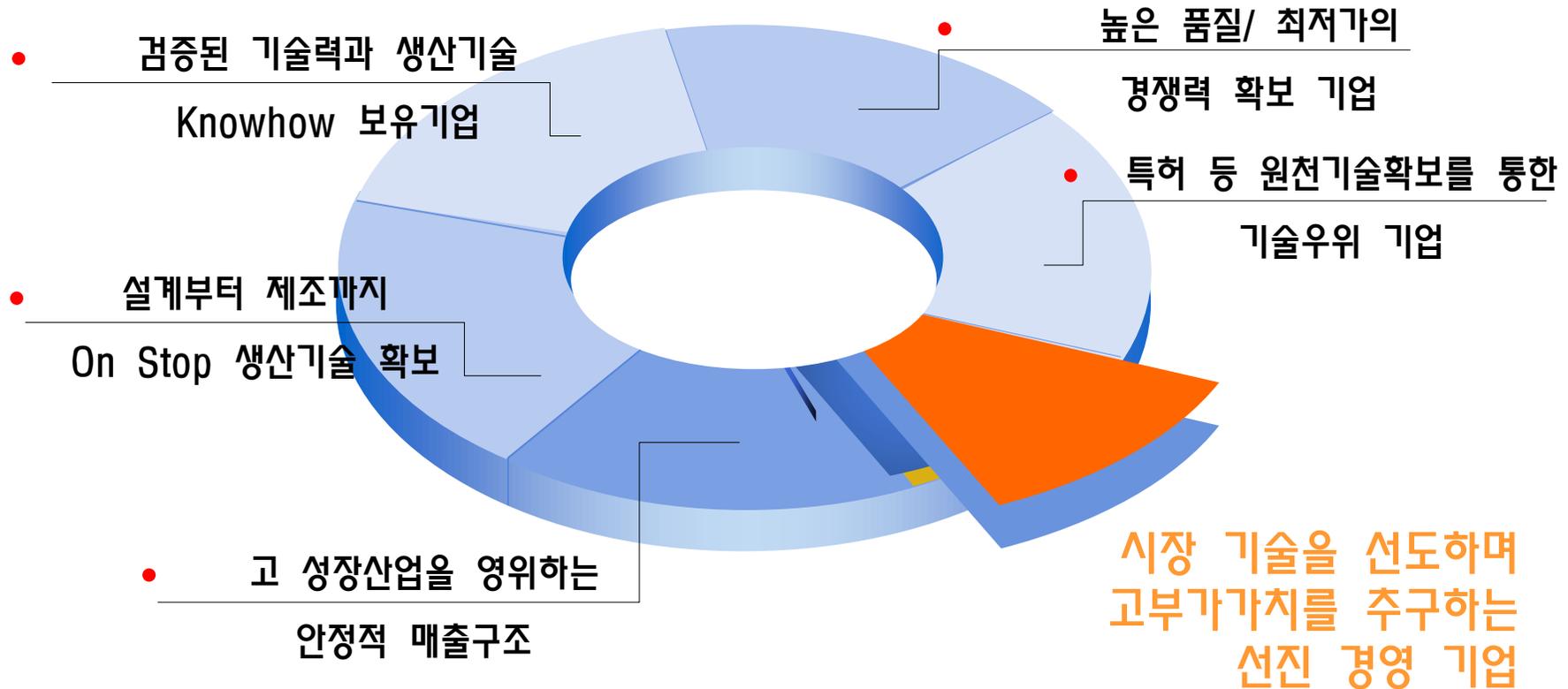
보다 많은 정보력과 기술력을 바탕으로 대한민국의 모든 중소기업들에게 우수한 첨단장비 인프라를 제공할 것입니다.

CEO *Dong Min. Kim*



(주)디엠텍코리아 Identity

첨단 도금장비 제조기업으로서
원천기술확보로 기술차별화 및 기업 경쟁력 우위 보유



(주)디엠텍코리아의 원가 경쟁력

- ❖최소의 비용과 효율적 설비투자로 최고의 품질 제품 생산
- ❖고객의 니즈에 최적화한 기획과 획기적인 생산공정 개발을 통한 원가 경쟁력 확보

강력한 원가 경쟁력

1. 자재 및 재료의 직접 수급
2. 전장물의 직접 구성, 조립
3. 국산화에 따른 시너지 효과
4. PKG, Module 단위의 생산
5. 공정의 최적·효율화를 통한 제조원가 하락

최고 효율의 Product Process



HISTORY

2003. 03	디엠텍 설립
2004. 12	SG메탈 #1,2 Reel to Reel Line Modify 제작
2005. 03	(주)연안테크 바렐&Rack 도금 장비 제작
2005. 07	Reel to Reel Line 설계, 기획 및 독자적 System 구축
2007. 06	천진 암페놀-K.A.E(주) LED Reel to Reel Line Modify 제작
2008. 07	(주)솔루에타 EMI Plating Line(Pre,Main,Au/Main/ATU)설계 제작
2010. 03	(주)연호전자 Reel to Reel Line 독일 장비 Modify
2011. 05	히로세코리아(주) Reel to Reel Line LED 장비 Modify
2012. 05	(주)두성산업 EMI Plating Line(Pre,Main,Au/Main/ATU)설계 제작
2012. 08	(주)디엠텍코리아 설립
2012. 09	(주)디에이치텍 EMI Plating Line(Pre,Main,Au/Main/ATU)설계 제작

HISTORY

2013. 02	한국몰렉스(유) Au 장비 제작
2013. 04	(주)KET SOLUTION 세정 라인 장비 제작
2013. 10	한국몰렉스(유) Au#1,2,3 LINE Modify
2014. 02	모아테크(주) Au-#1,2,3Line 장비 제작
2014. 06	(주)툽텍 EMI Plating Line 장비 제작
2014. 10	모아테크(주) Sn-Au #4,5,6 Line 장비 제작
2015. 01	(주)한국단자 Au-Line#1호기 제작
2015. 02	한국몰렉스(유) Sn-LINE 장비 제작
2015. 03~12	히로세코리아(주) Au BTB-LINE 10대 장비 제작
2015. 07	(주)케이씨텍 Au-Plating Line 2대 제작
2016. 01~12	히로세코리아(주) Au BTB-LINE 15대 장비 제작
2017. 07	한국몰렉스(유) Au-LINE 장비 제작

HISTORY

2017. 08	(주)KET SOLUTION Au/Sn-Line#2,3 장비 제작
2017.01~12	히로세코리아(주) Au BTB-LINE 15대 장비 제작
2017 .04	말레이시아몰렉스 Au/Sn 장비 Modify
2018. 03	중국상하이몰렉스 Au BTB-LINE #1 장비 제작
2018.01~11	히로세코리아(주) Au/Pd,Ni-LINE 6대 장비 제작
2018. 02	(주)코매프 Au/Pd-LINE 장비 제작
2018. 08	말레이시아몰렉스 Au,Sn,Au/Sn 기구물 장비 제작
2018. 09	일본-UI SCIENCE (태국 OKAME Au/Sn-LINE) 장비 제작
2018. 12	중국상하이몰렉스 Au BTB-LINE #2 장비 제작
2019.01~12	히로세코리아(주) Au BTB-LINE 16대 장비 제작
2019. 07	(주)대성하이피 판재라인 Modify
2019. 09	한국몰렉스(유) #G2,G4 Modify
2019. 12	중국상하이몰렉스 기구물#1 제작
2020. 02	말레이시아몰렉스 #M4-line(New U-Turn Line)
2020. 05	(주)KET SOLUTION New Au/Sn-Line(Reflow)장비 제작
2020. 07	일본-UI SCIENCE (OM-L3 Line) 장비 제작

Field of business

1

Connector Auto Plating 자동 / 수동 장비

- 1-1. 장비 모델화 제작
- 1-2. 도금 공정 기획
- 1-3. 장비 설계 및 제작
- 1-4. 전기 공사
- 1-5. 현장 SET-UP
- 1-6. 기구물

2

기타 도금 장비

- 2-1. Lead Frame 도금장비
- 2-2. 바렐 & Rack 도금장비
- 2-3. PCB 냉각 건조기
- 2-4. EMI 원단 도금장비
- 2-5. 프레스 오일 세척기
- 2-6. 기타



Organization Chart



1. 국내특허



Status of Certification

2. 해외특허

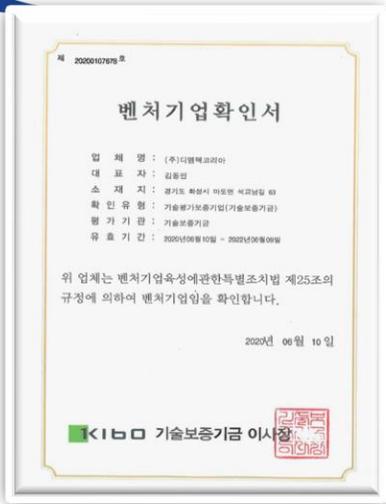


3.디자인등록증



Status of Certification

4. 벤처기업확인서



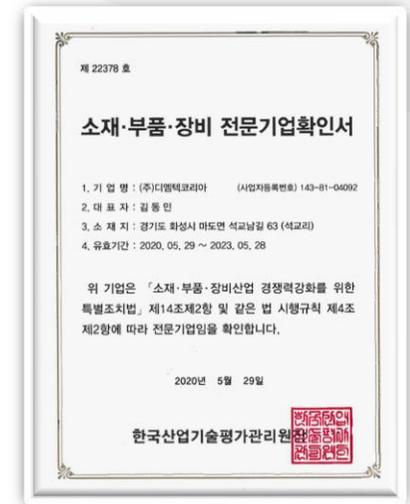
5. ISO인증서9001



6. ISO인증서14001



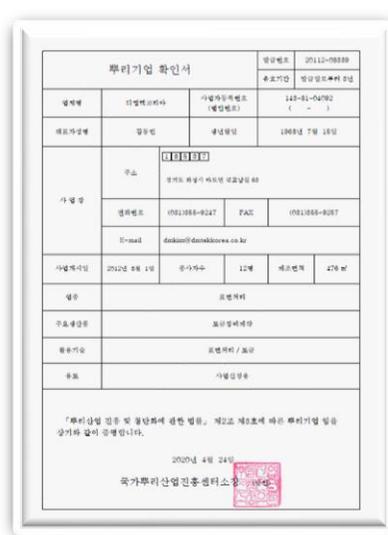
7. 소재부품확인서



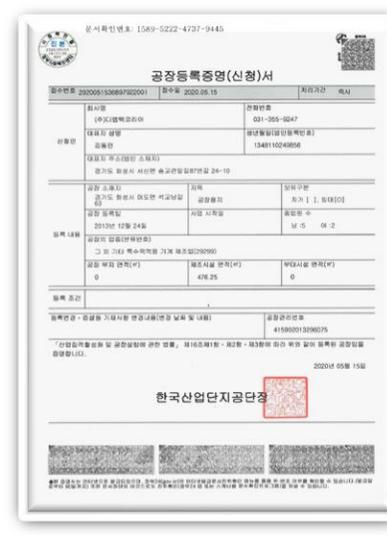
8. 기업부설연구소



10. 뿌리기업 확인서



11. 공장등록증



2

제품 소개



Product introduction

: Connector Auto Plating



Au-BtoB Connector Line

Note.
소형(0.4Pitch)커넥터 Ni-Au 고속
도금용 직선라인
도금속도 Max. 20M/min
라인 총 길이 48M



Au-Connector Accumulator 공정

Note.
도금속도 Max. 15M/min 일때
버퍼 시간 1분(PP롤러 4단)
Accumulator 높이 2M 적용

Product introduction

: Connector Auto Plating



Sn-자동차용Connector Line

Note.

Auto 전장 부품용(0.6t)커넥터 Ni-Au-Sn 고속 도금용 직선라인(Au & Sn부분도금 구조)
도금속도 Max. 10M/min, 제품t고려한
PP롤러Ø300설계
라인 총 길이 30M(좌,우 각각2strand 총 4stran도금)



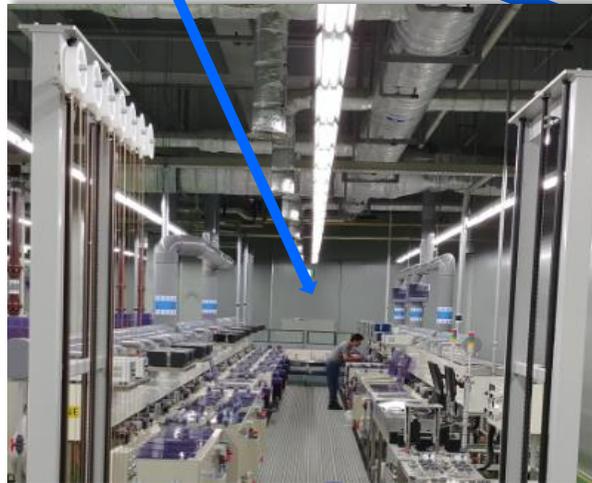
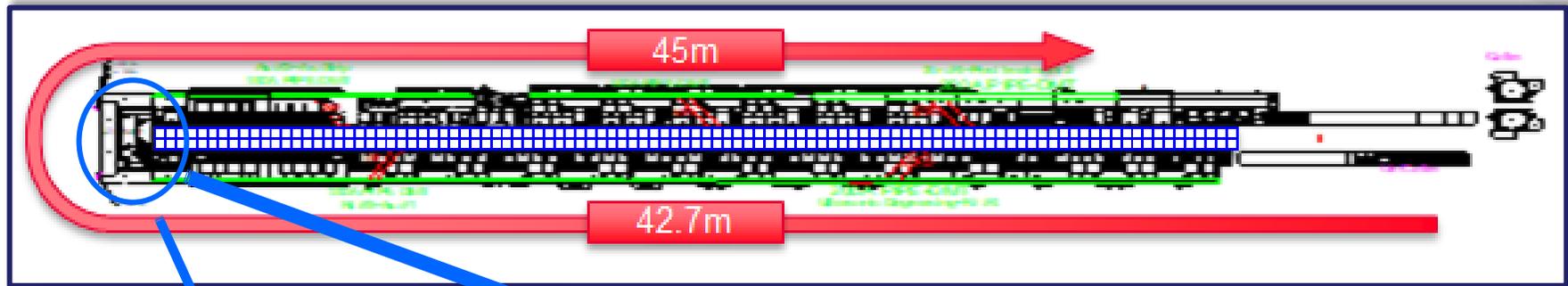
Au/Sn-자동차용Connector Line

Note.

도금속도 Max. 10M/min 일때
버퍼 시간 1분30초 (PP롤러 4단)
Accumulator 높이 2M 적용

Product introduction

: Connector Auto Plating



Au-Connector U-Turn Line

Note.

현장 설치 장소에 따라 "ㄷ"자 형태로 라인 설계

도금속도 Max. 20M/min

라인 총 길이 90M의 도금장비 효과발생



턴 구간 Tension조정 롤러 공정

Note.

초음파 센서 적용 제품 Tension 유지
"드럼 도금 적용 시 중요 공정"

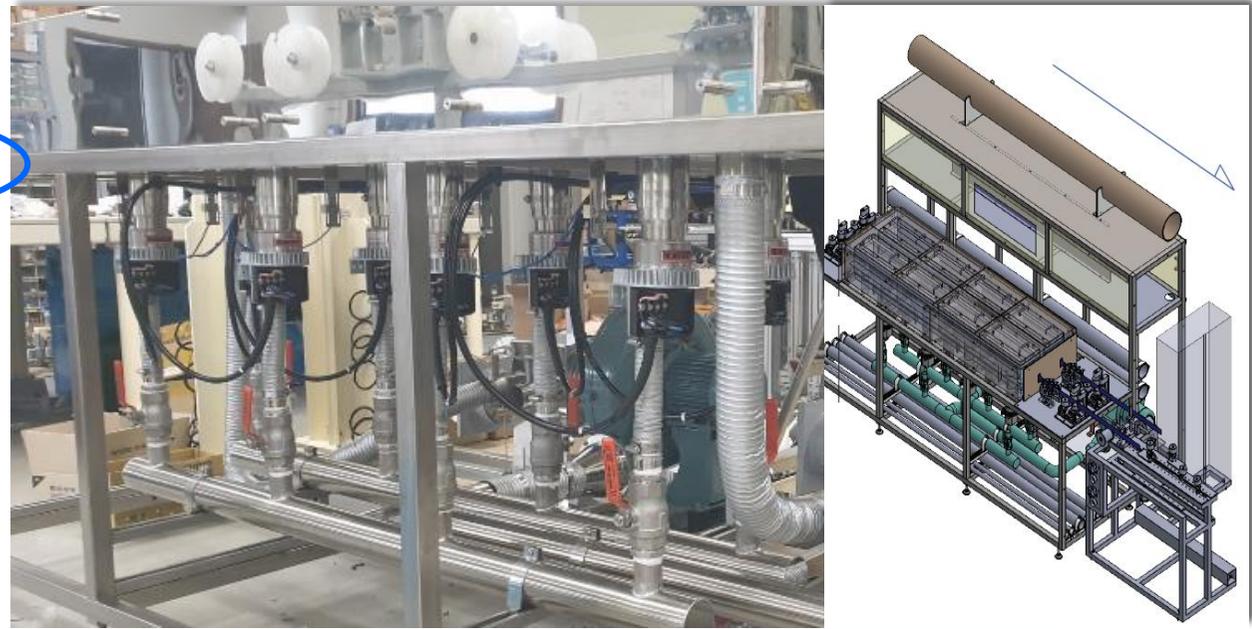
Product introduction

: Connector Sn-Reflow Plating



Sn-Connector Reflow 상부 CELL

Note.
외부 열풍가열 방식
챔버 내부 온도 ~700°C까지 온도 유지
온도 유지능력 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 내외
기본 속도 10M/min(도금 원자재에 따라 차이)



Reflow 하부 Heater & Blower 배관구조

Note.
송풍기는 공기 순환방식을 적용
(외부공기와 가열된 챔버 내부공기를 순환)
송풍량은 인버터 조절방식 적용(풍량 변화 최소)

Product introduction

: Connector Auto Plating

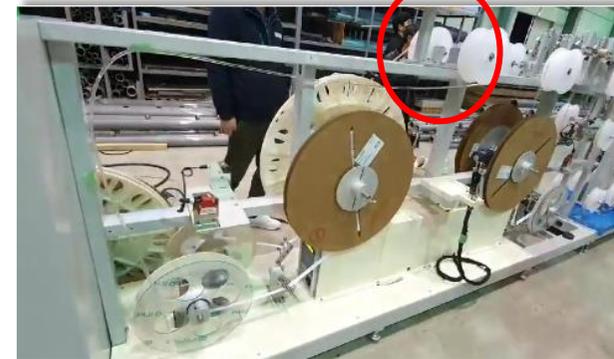


Au-Connector Un-coiler 공정

Note.

제품 투입공정으로 Tension조절 장치(특허)적용으로 릴에서 제품이 풀리는 동안 일정한 Tension을 유지 함. (도금 공정내에서 제품이 쳐지거나 도금 jig에서 이탈하는 경우를 방지하는 시스템)

제품 투입공정으로 Tension조절 장치(특허)적용으로 (릴에 감겨 있는 제품양을 레이저 센서로 감지하여 이 신호로 모터 속도를 제어하는 구조 임)



Note.

고속 도금의 경우 자동 spot용접기 제작 및 설치 가능한 설계

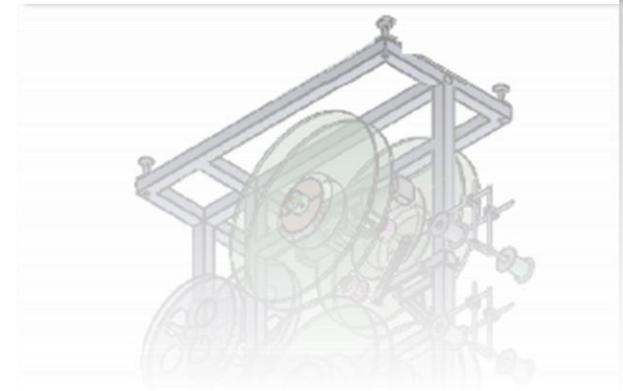
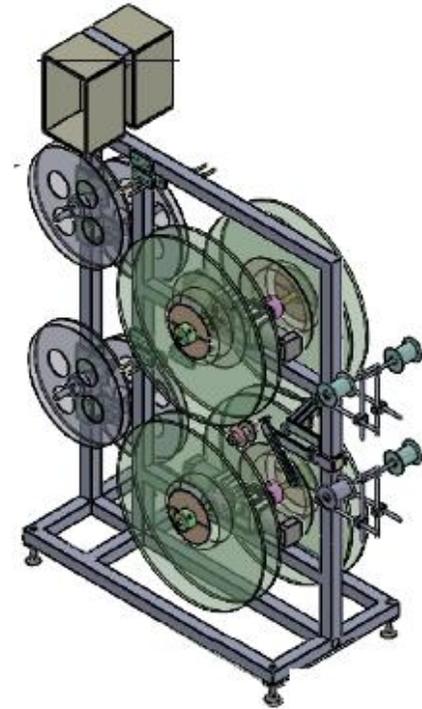
Product introduction

: Connector Auto Plating



Au-Connector Re-coiler 공정

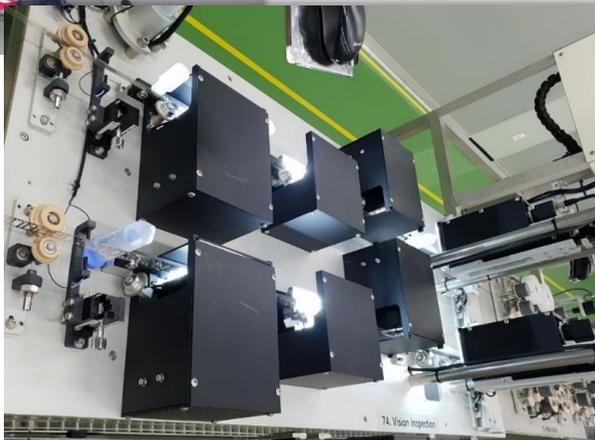
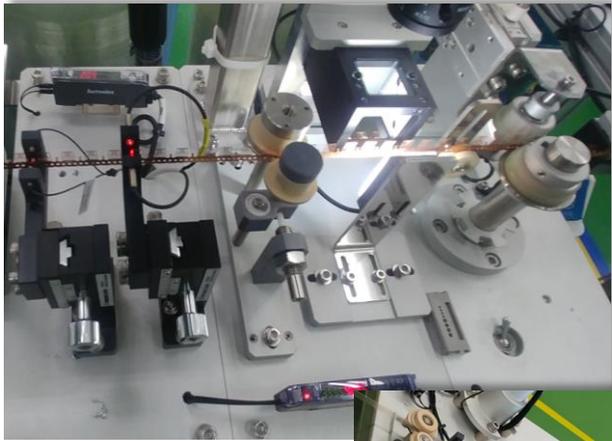
Note.
수평 2단 방식의 릴 체인지 형태의 구조



Note.
수직 2단 방식의 릴 체인지 형태의 구조

Product introduction

: Connector Auto Plating



Au-Connector Vision 공정

Note.
저속 도금공정용 단면 검사용(CAM1대 적용)
고속 도금 공정용 4면 검사(CAM4대 적용)

Au-Connector 전극 접점



Note.
일반 터미널용 로터리 전극 방식(캐리어 접촉)



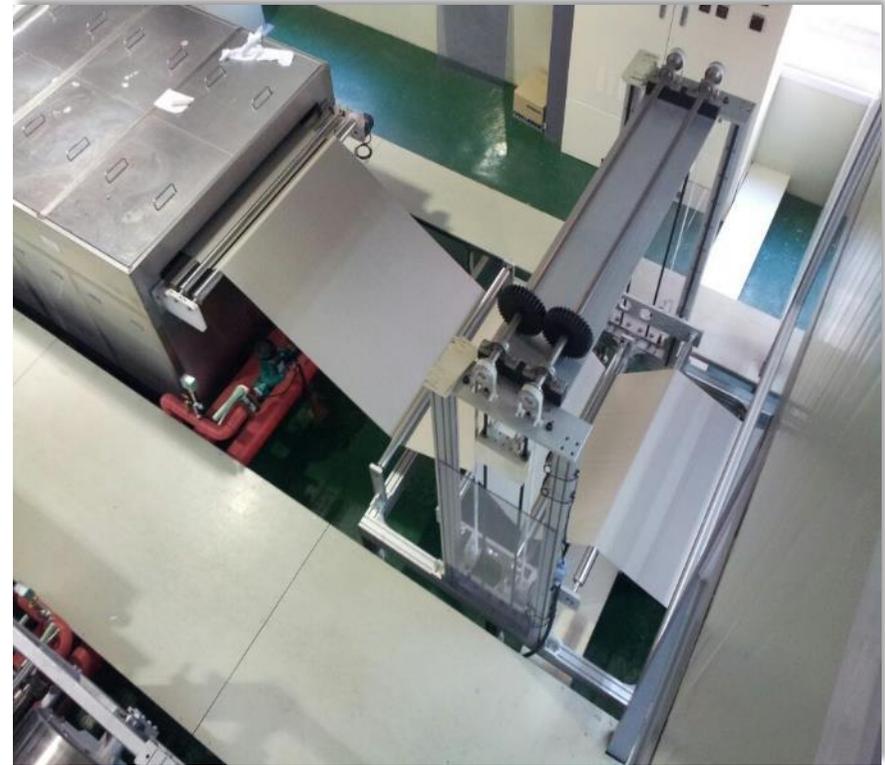
Note.
밴딩 제품 로터리 전극 방식(ㄷ 자 형태의 터미널)

Product introduction

: Connector Auto Plating



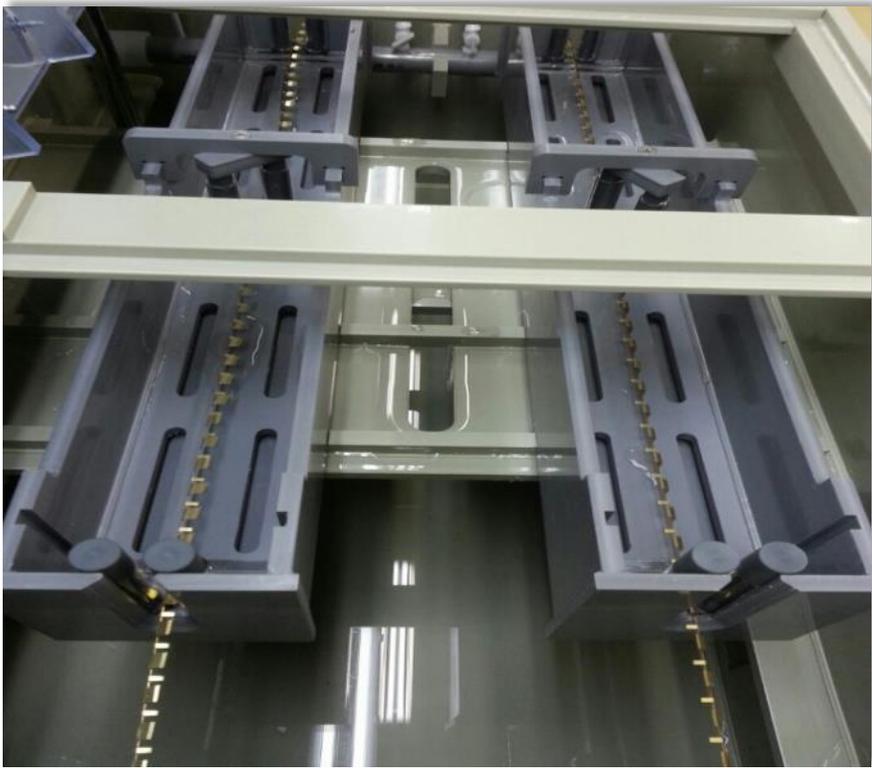
EMI Pre-Main Line



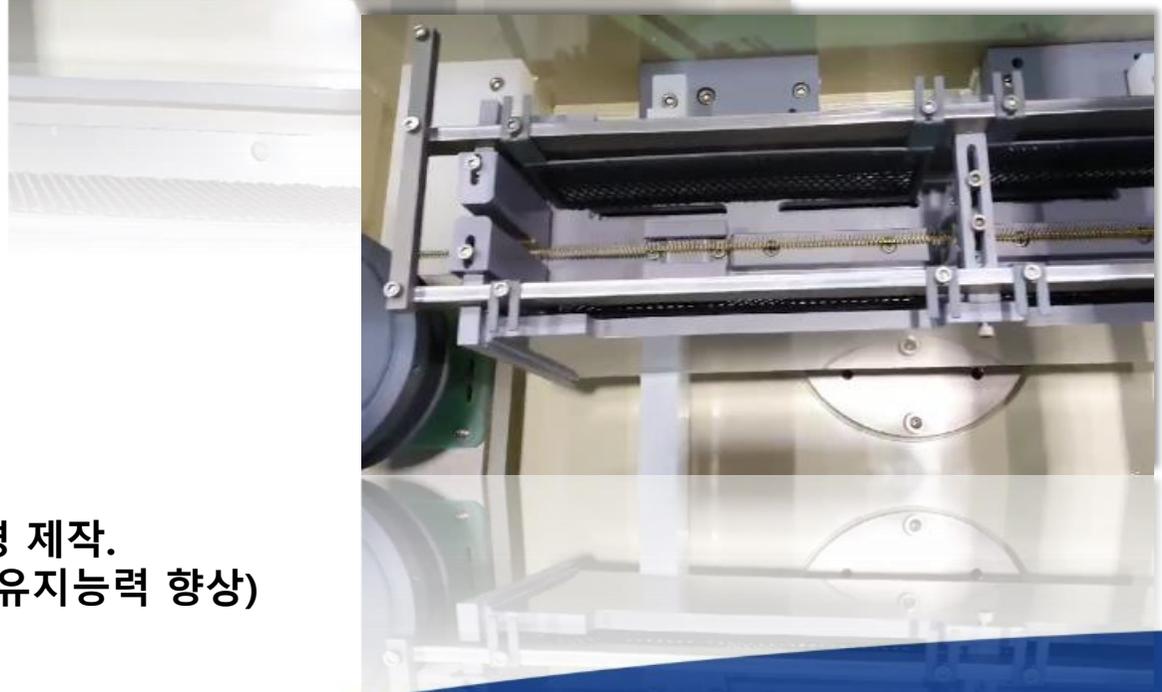
EMI Accumulator 공정

Product introduction

: Connector Auto Plating



Au-도금 라인 Innercell



Note.

용도에 따라 설계 변경

제품 형상, 전체 or 부분 도금 진행 여부에 따른 구조 변경 제작.

(인버터 적용으로 부분 도금의 경우 액 수위 조절 및 유지능력 향상)

Product introduction

: Connector Auto Plating



Au-도금 라인 Touch Panel



Note.

터치 패널 조작 방식
라인 작업 조건 세팅
(펌프, 정류기, 히터, 속도-자동, 수동 가능)

Product introduction

: Connector Auto Plating Line Driving



판재용 구동



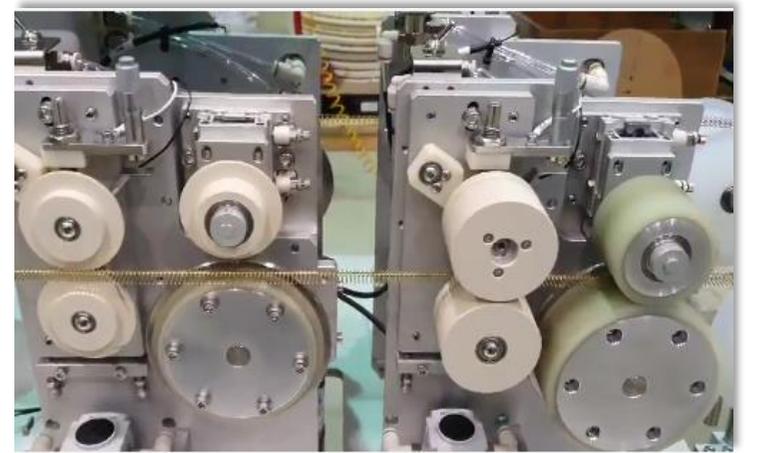
Connector I/O 단자용 구동



Connector 고속 구동



밴딩 제품용 구동 방식



SUB Drive

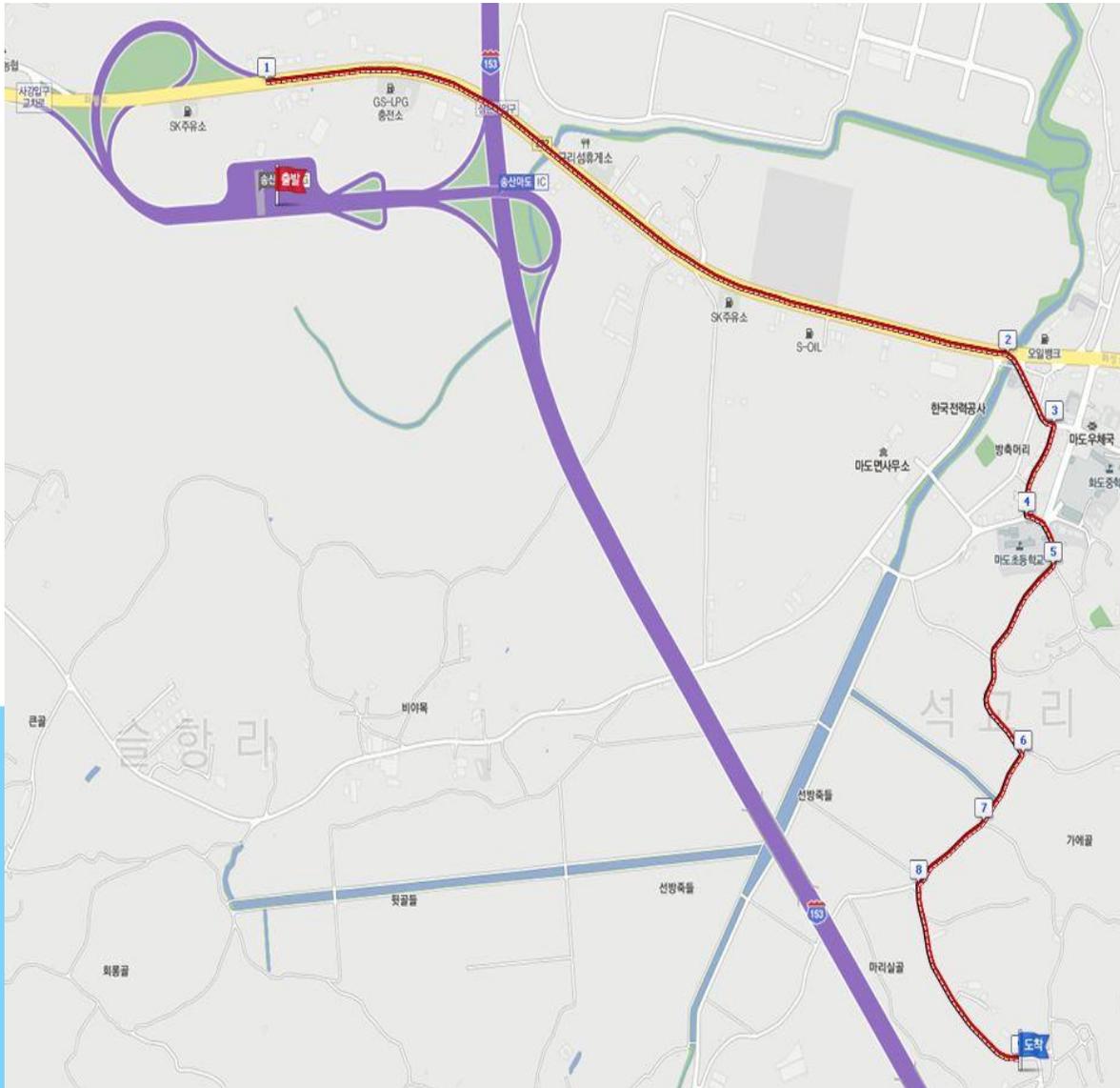
Note.
밴딩 터미널의 경우 접촉면 변형 방지를 고려한 구동방식

Major Clients



- 1. 한국몰렉스(유)
- 2. 태국 OKAME
- 3. (주)모아테크
- 4. (주)한국단지
- 5. (주)연호전자
- 6. (주)케이씨텍
- 7. (주)대성하이피

- 8. (주)코매트
- 9. 말레이시아 몰렉스
- 10. 중국상하이 몰렉스
- 11. 히로세코리아 (주)
- 12. (주)KET SOLUTION
- 13. 일본 UI SCIENCE
- 14. 기타업체



- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | 화성로 1.7km 직진 |   |
| 2 | 화성로 우측도로 173m 이동 |   |
| 3 | 석교로157번길 우회전 후 179m 이동 |   |
| 4 | 석교로157번길 좌회전 후 124m 이동 |   |
| 5 | 석교로 우측도로 429m 이동 |   |
| 6 | 석교로 우측도로 152m 이동 |   |
| 7 | 석교로 우측도로 186m 이동 |   |
| 8 | 석교남길 좌회전 후 419m 이동 |   |
| 9 | 도착지점 |   |

주소 : (신)경기도 화성시 마도면 석교남길 63번지
 (구)경기도 화성시 마도면 석교리 434-3번지

TEL : 031-355-9247



*약도 상세설명

송산, 마도 IC → 마도사거리에서 우회전 → 직진후 마도초교에서 우회전 → 직진 → 삼성자원에서 우회전 → 직진 후 마을 입구 삼거리 우측 → 디엠텍코리아



미래형 표면처리 장비를 만드는 기업

(주)디엠텍 코리아

감사합니다